

PLACA FRIA BAMBU PARA P1P, P1S, X1C Y X1E

FAP001+FAP003



Descripción:

Placa fría compatible con las impresoras 3D Bambu Lab P1P, P1S, X1C y X1E.

Cosas que debes saber antes de usar:

- Las variaciones en el color y el brillo de la apariencia de la placa de ingeniería y la eliminación de las áreas metálicas expuestas son solo ajustes menores para optimizar el proceso de producción y la calidad de la superficie. Si el revestimiento permanece en la boquilla cuando se limpia, se calentará y se derretirá antes de imprimir el modelo. Dichos cambios no afectan la nivelación, el lidar, la adhesión ni el rango de uso. ¡Puede comprar con confianza!
- Antes de realizar la nivelación automática, es necesario frotar repetidamente la boquilla en el área de limpieza especial de la placa de impresión para eliminar por completo cualquier material residual en la punta de la boquilla. El revestimiento en el área de limpieza especialmente diseñada se desgastará gradualmente con el tiempo. Esto es normal y no afecta la calidad de impresión ni la vida útil de la boquilla, por lo que no hay necesidad de preocuparse por problemas de calidad.
- Bambu Lab recomienda utilizar únicamente el pegamento oficial de Bambu Lab en la Cool Plate y no se hace responsable de ningún daño causado a las placas como resultado del uso de pegamento de terceros en las placas de construcción.

Pasos de instalación:

Paso 1: Alinee la placa con los puntos fijos de la plataforma con el nombre de la placa mirando hacia usted.

Paso 2: Bajar la placa y asegurarla a la plataforma magnética.



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Francisco Javier Hernández Ramos
Revisó	Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez
Fecha	21/01/2025

